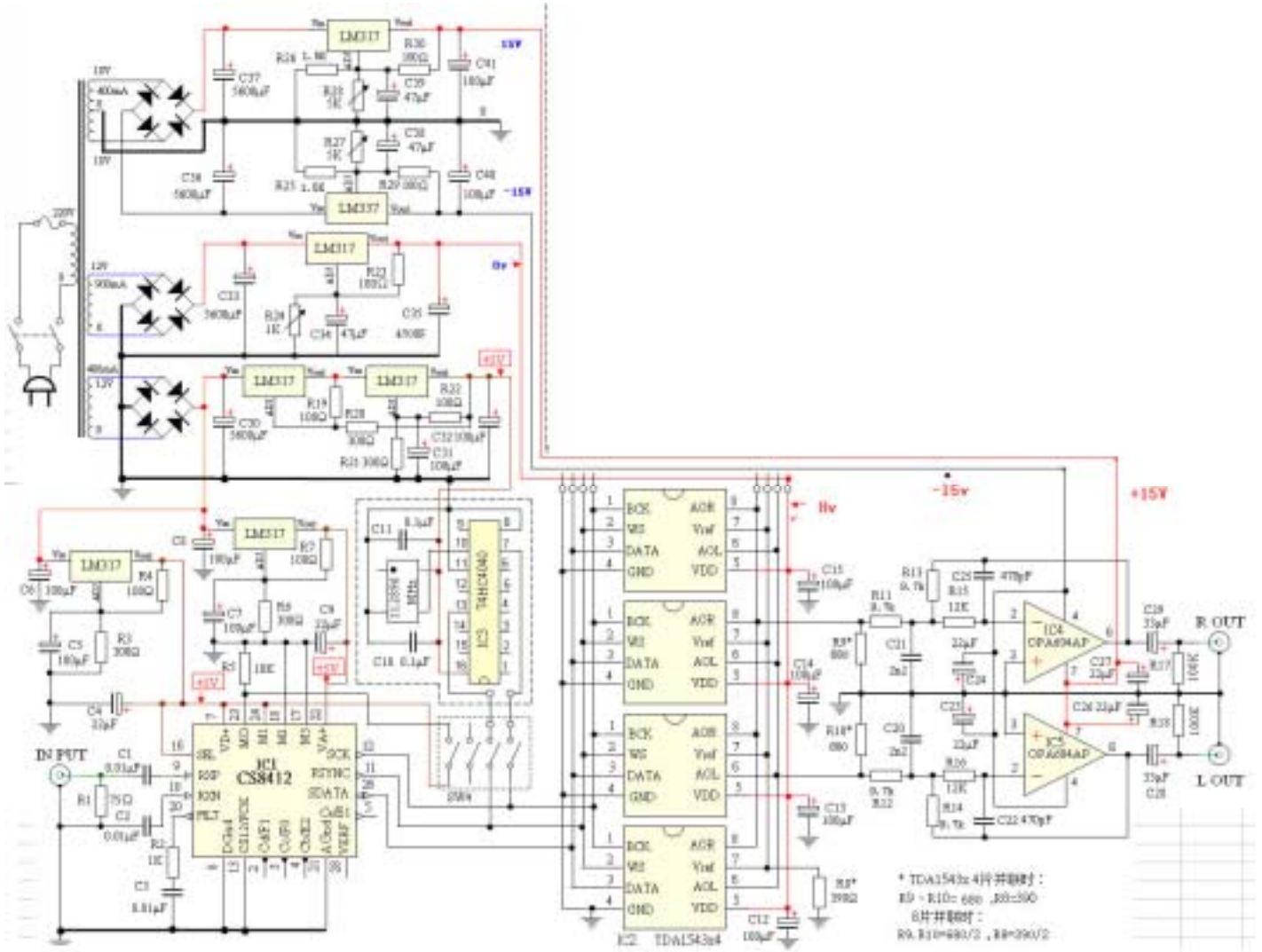


遲來的 TDA1543

by alexchiang

報告一拖就是 3~4 個月，遲遲未來的機箱(ps: jore 大大太忙了,快過年了, 忙著其它 case, 不好意思拖到他.) 所以理所當然的就拖到現在.

當然，首先，不管是新人或者老人(老玩家)，都應該先熟讀線路再下手，看到以下，要注意的只有三個點，+15V, + - 8V, 還有+5V, 當然，小電雖電不殺人，但是電容爆炸也是很危險的，要多多注意 ^_^...



將收到的電容分類.... 電容, 電阻, 主動原件, 端子台等等...



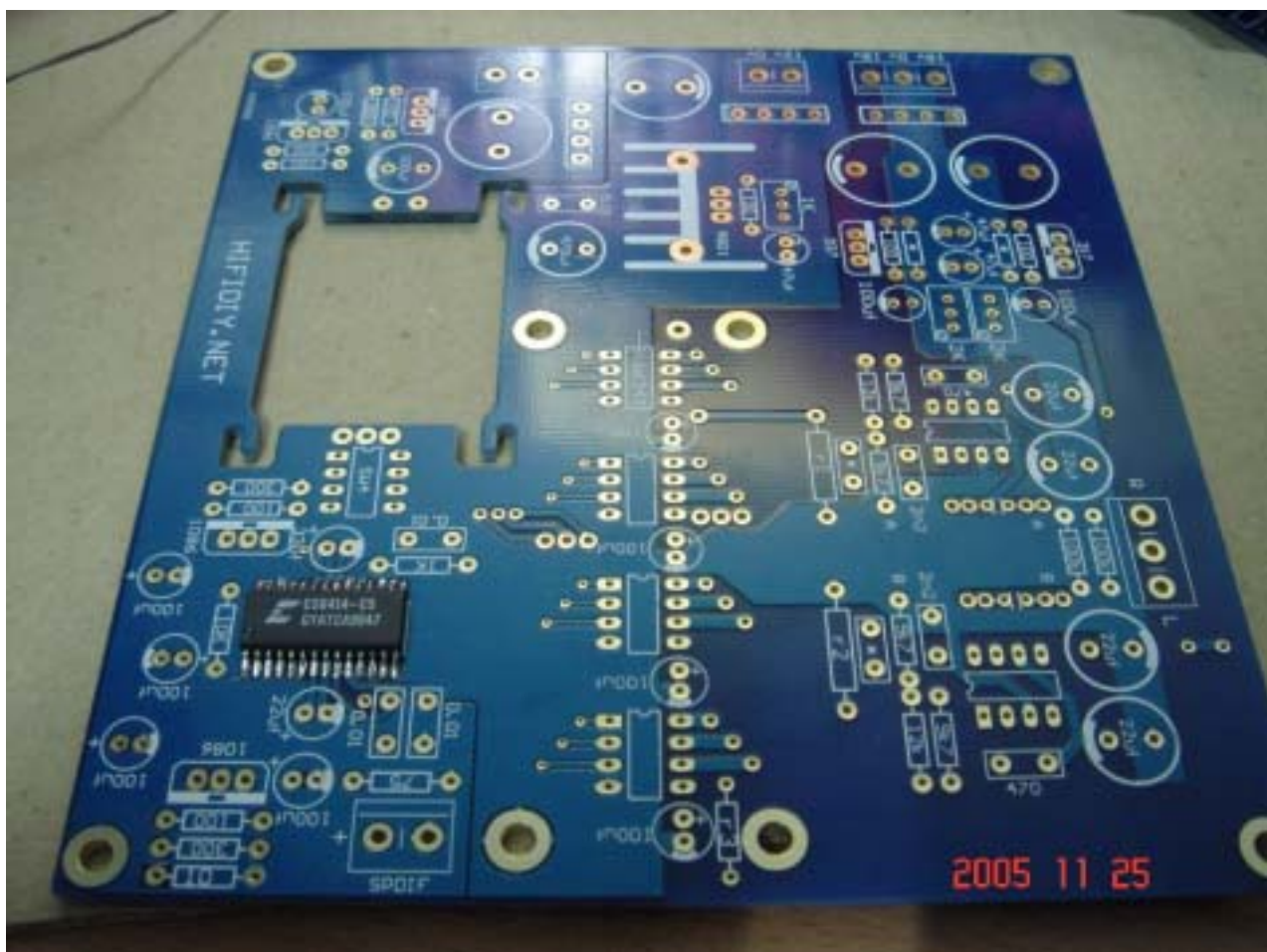
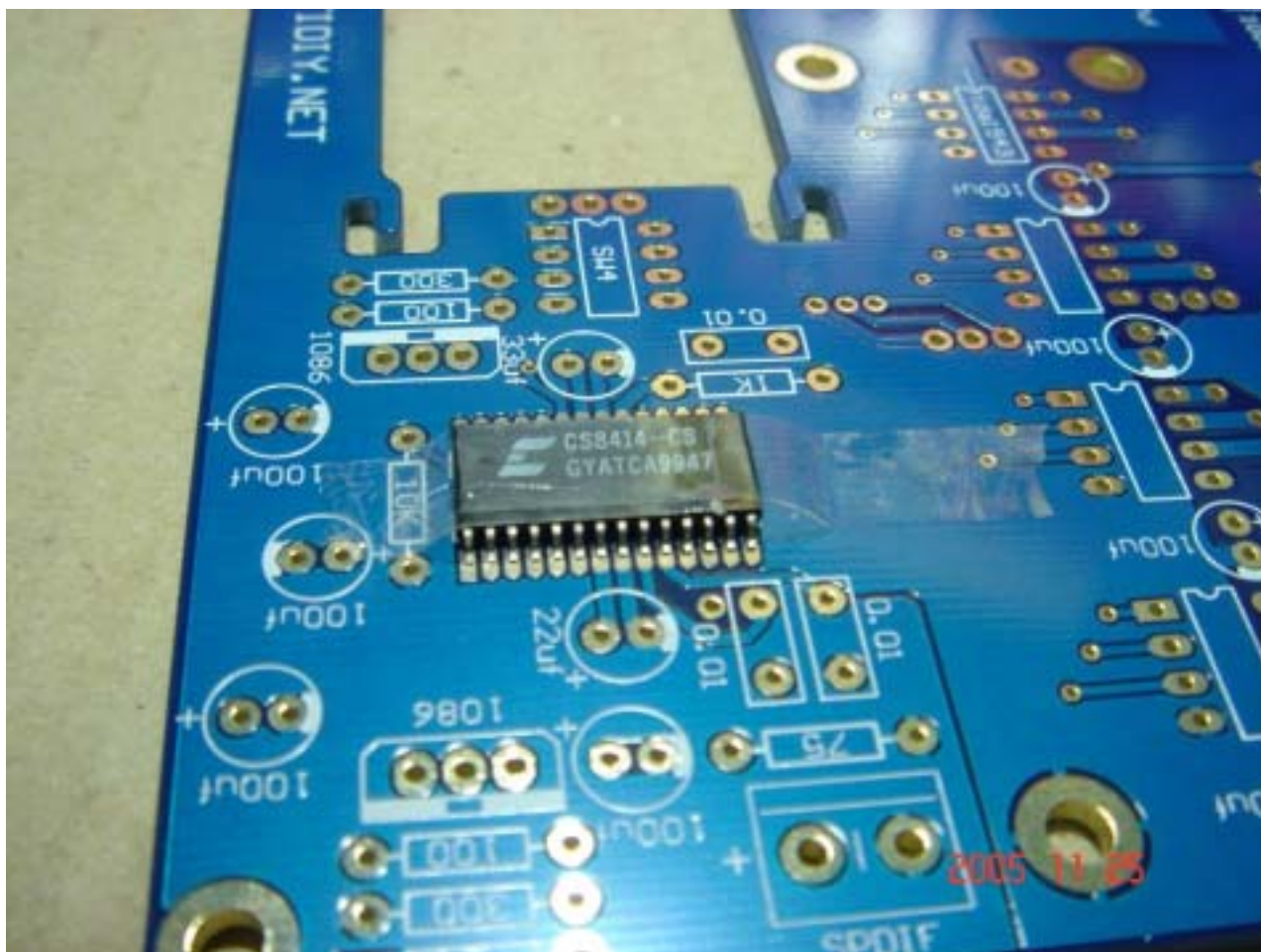
小弟現在封測廠工作, 順便跟大家提一下好了...

早期 IC 封裝型態太約如下, 我們的主角是第 4 種 SOP 包裝.

構裝型態	構裝名稱	常見應用產品
	Single In-Line Package(SIP)	Power Transistor
	Dual In-Line Package(DIP)	SRAM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH, Microcontroller
	Zig-Zag In-Line Package(ZIP)	DRAM, SRAM
	Small Outline Package(SOP)	Linear, Logic, DRAM, SRAM
	Plastic Leaded Chip Carrier(PLCC)	256K DRAM, ROM, SRAM, EPROM, EEPROM, FLASH, Microcontroller
	Small Outline Package(SOJ)	DRAM, SRAM, EPROM, EEPROM, FLASH
	Quad Flat Package(QFP)	Microprocessor
	Pin Grid Array(PGA)	Microprocessor

首先先挑戰最麻煩的 SOP 封裝焊接.....

先用膠帶先對齊貼上...再來就是細心+耐心的焊功...



最後就是小心臟...OSC 振盪器...



金剛合體...



以上照片有點暗(差), 小弟不是專業攝影人員請見諒...

以下就是 JORE 大大幫小弟拍的機箱照，很漂亮地...^o^...

